

99-2 大葉大學 選課版課綱

基本資訊

課程名稱	電子封裝概論	科目序號 / 代號	1837 / MAI4024
開課系所	機械與自動化工程學系	學制 / 班級	大學日間部4年4班
任課教師	鄭江河	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(二)56 / H466 (三)9 / H466	授課語言別	中文

課程簡介

電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。

課程大綱

- 1 前言
- 2 聯線技術
- 3 塑膠構裝
- 4 陶瓷構裝
- 5 薄/厚膜技術
- 6 捲帶自動接合
- 7 覆晶接合
- 8 異方性導電膠
- 9 新型構裝技術

基本能力或先修課程

半導體製程、微機電系統概論